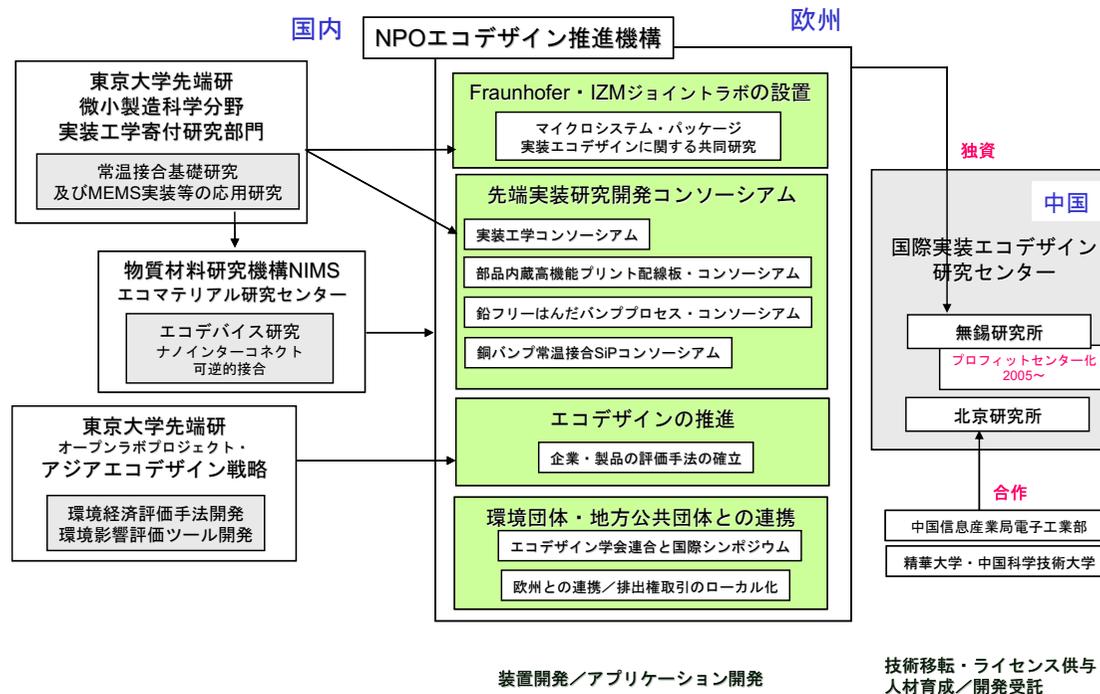


NPOエコデザイン推進機構中国拠点ECOPAC沿革

■ 東京大学先端科学技術研究センター（先端研）での活動

- 2001年度：科学技術振興調整費戦略的研究拠点育成プログラムの一環として、2002年度先端研オープンラボプロジェクト「アジアエコデザイン戦略」およびTechnology Business Incubation (TBI) Program「実装エコデザイン」（代表者・須賀唯知）が発足。
 - ・ アジアエコデザイン戦略：特任教授：藤本 淳；特任助手：中村一彦
 - ・ 実装エコデザイン：特任研究員：徐忠華Xu Zhonghua、林秀臣、塚本勝彦



- 2002年9月：NPOエコデザイン推進機構発足
 - NPOをベースに民間企業と東京大学との共同研究を実施（間接経費をNPO運営へ）
 - ・ 微細接続プロジェクト（2社500万）
 - ・ 鉛フリーはんだバンプコンソーシアム（3社600万）
 - ・ 中国エコデザイン戦略研究会（5社ナガセケムテック”、フジクラ、野田スクリーン、新川、T&K：800万→中国拠点ECOPAC設置へ）
 - ・ 電子ビーム応用のコンソーシアム（3社荏原, JSR, 東京エレクトロン7,000万→寄付研究部門設置へ）
- 2003年4月：ドイツFraunhofer研究所IZMとNPO共同でジョイントラボJoiLITを設立（Hansjorg Griese氏）
- 2003年7月14日：中国無錫に実装エコデザイン国際研究所ECOPACを設立
（正式名称）无锡艾克柏国际微电子科技有限公司
- 2004年4月：寄付研究部門・実装エコデザインを設置（～2008年；奥村勝弥客員教授）
- 2005年11月：東京大学無錫代表処設置
- 2009年5月：ECOPACクリーンルーム建設
- 2010年3月：開所式（東京大学無錫代表処国際産学無錫研究センター・ECOPAC）
- 2015年12月：ECOPAC事務所移転
- 2019年3月：東京大学無錫代表処解散
- 2024年6月：ECOPAC解散（予定）

国際実装エコデザイン研究所

設立趣旨

環境の世紀と呼ばれる21世紀において、資源循環型でエネルギー消費効率の高い社会の構築は人類共通の課題であり、これに対するさまざまな障害を克服するには、社会のあらゆる活動を環境に調和するよう設計しなおし、変革していくこと、つまり『エコデザイン』が必要とされています。この『エコデザイン』を推進していくためには、産業においては、環境配慮型製品・生産技術、リサイクル・リユースなどの逆工程技術、安価で安全な廃棄処理技術、これら技術の適切な組合せでライフサイクル全体の環境負荷を最小にする設計技術などの技術開発が望まれます。

このような課題に対し、特定非営利活動法人エコデザイン推進機構では、産業界とアカデミアの連携により、エコデザインのコンセプトを普及させるために、エコデザイン国際会議の企画・運営やエコデザインに関する研究会やセミナーの主催、また、エコデザインおよび実装に関する研究開発促進を目的とした、エコデザイン実装関連コンソーシアムやプロジェクトへのサポートを行ってきています。今後、特定非営利活動法人エコデザイン推進機構では、日本国外の研究機関や企業とも連携を行い、エコデザイン及び実装に関する幅広い分野での情報共有や国際的な技術交流も行っていきたいと考えています。

『国際実装エコデザイン研究所』は、特定非営利活動法人エコデザイン推進機構の中国における産学連携の拠点として、先端実装およびエコデザインに関わる中日のアカデミア・産業界の人的ネットワークを構築し、これらのネットワークを基にした中日両国企業・アカデミアとの共同プロジェクトの推進を行っていきます。これにより、日中両国の知識の創造・発展に貢献し、さらに持続的な発展が可能な社会基盤の構築を行います。

研究所の概要

	国際実装エコデザイン研究所
名称	中国名：無錫エコパック国際微電子科技有限公司 英語名：International EcoDesign and Microelectronic Packaging Research Institute Limited
設立	2003年7月
資本金	6.2万米ドル（NPO法人エコデザイン推進機構（100%））
役員	董事長 小渋弘明（NPOエコデザイン推進機構理事長） 総経理 安食弘二（NPOエコデザイン推進機構理事）
電話/FAX	+86 (510) 522-5248

ECOPAC
Research Institute

[実装エコデザイン研究所](#)

[事業内容](#)

[メンバーシップ](#)

[リンク](#)

[エコデザイン推進機構](#)

[お問い合わせ](#)

What's New

- [3rd International Conference on Eco-Electronics](#)を開催（南京、2007.10.25-26）
- [2nd International Eco-electronics Conference](#) を開催（北京、2006.12.7）
- [1st International EcoDesign Electronics Symposium](#)を開催（上海、2004.2.5）
- オープニングセレモニーを開催（2003.9.12）
- 国際実装エコデザイン研究所開所（2003.8.1）



研究所のある無錫新区情報産業園

- ◆ 東京大学の委託により、東京大学無錫代表処の運営をサポートしております。



国際実装エコデザイン研究所は、中国でエコデザインを推進する企業等を対象に、無錫市と協力し、東京大学を中心とした日中大学・研究機関とのネットワーク作りのサポートや産学連携のコーディネーション、人材育成を行っています。

- 環境分析受託業務
- 鉛フリー実装に関する調査・セミナー
- Ecodesign Chinaコンファレンスの運営
- 東京大学無錫代表処の運営補佐業務の受託
- 中国大学—東京大学共同研究のための実験スペース供与
- その他、エレクトロニクス関連、環境関連の研究開発動向調査等

<http://www.i-ecopac.com/jp/index.htm>

编号 320214000301709040223



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 9132021475001257X1 (1/1)

名称 无锡艾克柏国际微电子科技有限公司
 类型 有限责任公司(外国法人独资)
 住所 无锡国家高新技术产业开发区信息产业科技园A楼301-304室
 法定代表人 小濑弘明(KOSHIBU HIROAKI)
 注册资本 6.2万美元
 成立日期 2003年07月14日
 营业期限 2003年07月14日至2053年07月13日
 经营范围 微电子封装技术和绿色设计技术的研究、咨询、培训(不含发证)及自行研发技术的转让;国际科技信息咨询服
 务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2017年06月04日

企业信用信息公示系统网址: www.jsgsj.gov.cn:58888/province

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

外资企业

无锡艾克柏国际 微电子科技有限公司



程

2003年6月1日



无锡工商行政管理局新区分局
20180603122660001 14号

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》和其它有关法律、法规的规定,绿色设计推进机构(日文名:绿色设计推进机构)决定在中国江苏省无锡市国家高新技术产业开发区,建立外商独资经营公司无锡艾克柏国际微电子科技有限公司,特制定本章程。

第二章 公司的名称及地址

第二条 公司名称
 中文:无锡艾克柏国际微电子科技有限公司
 英文:International EcoDesign and Microelectronic Packaging Research Institute Limited (简称ECOPAC)。

第三条 公司法定地址:中国江苏省无锡市国家高新技术产业开发区长江路21号信息产业科技园A楼301-304室

第三章 投资者

第四条
 投资方:绿色设计推进机构
 注册地:日本东京都文京区本驹込5丁目16番9号
 法定地址:日本东京都文京区本驹込5丁目16番9号
 法定代表人:小濑弘明
 职务:董事长
 国籍:日本

第四章 组织形式和法律管辖

第五条 公司为中国法人,受中国法律管辖和保护,其一切经营活动遵守中国的法律、法令和有关条例的规定。

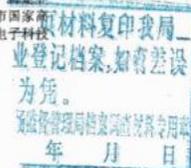
第六条 公司为有限责任公司,投资方以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

第七条 如果公司未来业务发展有需求,根据中国的相关法规,公司将在中国其它地方或者国外设置分公司、办事处等。

第五章 宗旨、经营范围



无锡工商行政管理局新区分局
20180603122660002 14号





UT International Univ.-Industry Cooperation (WuXi) Center
东京大学国际产学研合作（无锡）中心
运营组织：无锡艾克柏国际微电子科技有限公司

中国江苏省無錫市新区無錫（国家）软件园（iPark-II）

Office + Cleanroom (class 10,000 / 50m² + class1,000 / 150m²)

Screen Printer, Ball placer, Plasma Reflow, ICP, UV, SEM



5th MOST-JST Workshop on

Advanced Interconnect Technology & Ecodesign

Solder Bumping, Plating Technology, TSV, Low Temperature Bonding Processes, MEMS packaging and the Reliability

2010. 8.23 (Monday)

Millennium Hotel, WuXi New District, China

Organized by
The University of Tokyo WuXi Representative Office
Sponsored by Japan Science and Technology Agency (JST)
NPO EcoDeNet / ECOPAC

8:30~8:50 Registration

8:50~10:40 Opening Remarks and Session I

8:50~9:10 Opening Remarks and U-Tokyo WuXi Activities Introduction
9:10~9:30 Prof. T.Suga (U-Tokyo): Low temperature Bonding Process for 3D Integration
9:30~9:50 Prof. M.Li (SJTU): Cu Electroplating Technology for TSV 3D-IC
9:50~10:10 Prof. H.X.Zhang (Peking Univ.): MEMS Energy Harvesting Devices

10:10~10:30 Break

Session II

10:30~10:50 Prof. Kariya (Shibaura Inst. Technol.): Environmental Friendly Lead-free Solder and Reliability
10:50~11:10 Nihon Superior: Trend of Lead-free Solder
11:10~11:30 Prof. D.Y.Ding (SJTU): Tin Whisker Research in SJTU
11:30~11:50 MINAMI: Screen Printing and Wafer Bumping for Advanced Packaging
11:50~12:10 Senjiu Metal Industry Co., Ltd: Micro Solder Ball for Semiconductors

12:10~14:00 Lunch Break

Session III

14:00~14:20 JPC: Quality Control of Surface Finish Treatment
14:20~14:40 Fujitsu: Quality Reliability Control in WuXi Lab
14:40~15:00 Dr. P.Mou (Tsinghua Univ.): Green Semiconductor Technology

15:00~15:20 Move to U-Tokyo Lab by Bus

15:00~17:30 Lab Tour & Demonstration (MINAMI, JPC etc.)

17:30~18:00 Back to Hotel by Bus

18:00~20:00 Dinner at Hotel

Contacts:

Prof. Tadatomo SUGA, Assoc. Prof. Jian LU (Email: jian.lu@su.t-u-tokyo.ac.jp)
School of Engineering, The University of Tokyo

Japan: Hongo 7-3-1, Bunkyo-ku, 113-8656, Tokyo Tel: +81-3-5841-6491 Fax: +81-3-5841-6485
China: Sheshou Building A 201-203, Wuxi National Software Park, Zhenze Road 18#, WND, WuXi
Tel: +86-510-85225248 +86-(0)138-12076393 Fax: +86-510-85225248
Website: <http://www.en.t.u-tokyo.ac.jp/100823-workshop/index.html>

About the Center

To promote the cooperation between Japan and China in the field of education, research and academic-industry collaboration, The University of Tokyo, in cooperation with WuXi New District (WND), launched the International University-Industry Cooperation Center on Mar. 22, 2010. The center currently engages in collaborations with universities and industries on environmental friendly semiconductor technology, including IC-packaging, MEMS, MEMS-packaging, and sensor network. Any advices and proposals are welcomed for future activities.



TV Conference system



Students Lab



Cleanroom (class 1,000)

Green Electronic Materials



Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS)

UV-Visible Reflection Spectroscopy



Topic I: Green electronic materials for IC and MEMS packaging.

3D Structures by Lithography

Topic III: 3D structure for MEMS device and IC packaging.



High-density Solder Printing/Reflow



Solder Printer Ball Placer (8~12 inch. Wafer)

Plasma-assistant Reflow (8~12 inch. Wafer)

Topic II: High-density 3D interconnect and packaging using lead-free solder bump by printing technology.

MEMS & Sensor Network

Topic IV: MEMS application in WSN ...

Contacts:

Prof. Tadatomo SUGA, Assoc. Prof. Jian LU (Email: jian.lu@su.t-u-tokyo.ac.jp)
School of Engineering, The University of Tokyo
Hongo 7-3-1, Bunkyo-ku, 113-8656, Tokyo Tel: +81-3-5841-6491 Fax: +81-3-5841-6485

■ 運営体制

- 董事長：小渋弘明(2003~2019)、須賀唯知(2019.12.30~)
- 総経理：中村一彦(2003~2008)、安食弘二(2008~2013)、森はるか(2014~)
- 事務局：李英Li Ying 2004~2024；陈丹Chen Dan 2009~2018
- ；杨红娟Yang HongJuan 2005~2009；王玲Wang Lin 2006~2007；江丽Jiang Li 2003~2004

■ 東京大学無錫代表処の運営

- 特任准教授：徐忠華Xu Zhonghua(2005~2008)
- 特任准教授：魯健Lu Jian(2008~2011)
- 特任研究員：王英輝Wang Yinghui (2011~2019)

東京大学大学院工学系研究科と
特定非営利活動法人エコデザイン推進機構
との間における中国拠点に関する協定書

東京大学大学院工学系研究科と特定非営利活動法人エコデザイン推進機構は、中国研究拠点の運営に関し、ここに次の様な学術研究促進のための協定を締結する。

■ 民間との共同研究

- ミナミ株式会社
- ウシオ電機
- 日本高純度化学
- 日本CMK 他

■ 中国大学・研究機関との交流

- 清華大学、北京大学、上海交通大学、復旦大学
- 中国科学技術大学、江南大学、南京大学、南海大学
- 中国科学院微電子研究所（北京）
- 中国科学院マイクロシステム研（上海）
- 中国科学院ナノバイオ研SINANO（蘇州）
- Motorola
- MEMSIC, Wuxi
- Nantong Fujitsu
- SAMSUNG, 他



第2条 特定非営利活動法人エコデザイン推進機構は同機構の中国拠点である国際実装エコデザイン研究所を通じ、東京大学大学院工学系研究科が設置した中国江蘇省無錫市新區情報産業園の東京大学無錫代表所の上記の活動、ならびに同所の運営を支援する。

第3条 本協定は締結の日から3年間有効とし、3者のいずれかから期間満了の6カ月前までに協定廃止の申し出がない限り、更に以後3年間更新できるものとする。

第4条 本協定の修正は両者の協議によって行う。

2011年10月25日
東京大学大学院工学系研究科
研究科長 北森 武彦

2011年10月25日
特定非営利活動法人エコデザイン推進機構
代表理事 小渋 弘明

■ ECOPAC閉鎖に至る経緯

- ECOPACは2003年にNPOエコデザインネットワーク出資の有限公司として設立・登記され、2005年に設置された東京大学工学系無錫代表処の運営組織として、また、日本企業との共同研究、中国大学研究機関との実装エコデザインの研究開発の交流の場としての機能を果たしてきた。
- しかし、中国政府の手厚い補助により中国大学のインフラは日本の大学を凌駕するまでに格段に改善し、また日本企業も中国リスクから中国との共同開発に躊躇する場面が増えたことから、その役割は縮小し、また東京大学は各所にあった100あまりの海外拠点を整理・統合し、その一環として、北京代表処に続き、2019年無錫代表処を閉室することとなった。
- ECOPACは開設以来、無錫政府のサポート、東京大学工学系の運営費（年間~300万円）、NPOエコデザイン推進機構を通じた日本企業との共同研究費、中国でのセミナーなどのイベント収入により、事務所、クリーンルームなどを運営してきたが、この状況を受け、2019年に活動を停止、以来、登記維持のための最低限の事務管理のみを継続してきた。
- しかし、最後の事務員の李英氏が定年を迎えるにあたり、資金も底をつくことから、有限公司としての組織を解散することとした。
- これまで資本金62千US\$（~51万RMB）に加え、通算して、650万RMBの収入があったが、本年度6月末ですべて支出予定であり、また資産等はすでに処分済みである。解散に至る手続きについては、設立来、財務会計は税理士の公式の監査を受けており、問題はない見込みである。